

希荻微电子集团股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

的审核问询函回复的修订说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市诚芯微科技股份有限公司 100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 5 月 13 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于希荻微电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）（2025）12 号）（以下简称“《审核问询函》”），并于 2025 年 7 月 29 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露了《希荻微电子集团股份有限公司关于上海证券交易所〈关于希荻微电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函〉之回复（修订稿）》及相关文件。

鉴于本次交易审计基准日更新至 2025 年 6 月 30 日，同时根据上交所的进一步审核意见和相关法律法规的规定，公司会同相关中介机构就审核问询函回复进行了修订、补充及完善，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于上海证券交易所<关于希荻微电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>之回复（修订稿）》及其他相关文件。

本次交易尚需满足多项交易条件后方可实施，包括但不限于上交所审核通过、

中国证监会同意注册等。本次交易能否取得上述批准和注册，以及最终取得批准和注册的时间存在不确定性。

为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，公司将严格按照相关法律法规的规定披露本次交易事项的进展情况。有关信息均以公司指定信息披露媒体和上交所网站发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日